Frore Systems 出品 AirJet®Mini G2 助力 Qualcomm 二合一笔记本与迷你电脑参考设计实现静音且持续的 AI 性能

继在 COMPUTEX 首次亮相后，AirJet®Mini G2 如今已随合作伙伴的实机系统登录 CES 舞台，并助力 Frore Systems 连续第三年荣获 CES 创新大奖。

美国加利福尼亚州圣何塞 – 2025 年 12 月 30 日 —— Frore Systems 今日重点展示了其迄今为止性能最强劲的固态主动散热芯片——AirJet®Mini G2 的强劲发展势头。该产品已在 CES 的合作伙伴实机系统中展出，其中包括 Qualcomm Snapdragon X2 Elite 二合一笔记本及迷你电脑（Mini-PC）参考设计。

AirJet®Mini G2 最初于 2025 年的 COMPUTEX 展会上揭晓。其被 Qualcomm 迅速采用，标志着该技术已从突破性原型跨越到可部署的平台化设计。这反映了 Frore Systems 一贯的专注点：随着 AI 工作负载日益向紧凑型、无风扇设备迁移，将热管理创新转化为持续的、现实世界的性能表现。

此外，AirJet®Mini G2 还为 Frore Systems 赢得了连续第三座 CES 创新大奖（CES Innovation Award），再次彰显了行业对固态主动散热技术的高度认可，该技术旨在消除下一代 AI 系统的散热瓶颈。

基于成熟的商业部署经验

AirJet®Mini G2 的研发基于已经商业化部署且持续增长的 AirJet Mini 设计基础，其中包括已投入使用的任务关键型通信设备。

例如，AT&T 推出的 Sonim MegaConnect™ 是全球首款超紧凑 Power Class 1 5G 移动热点，现已在 AT&T 搭建的 FirstNet® 平台上正式出货。该设备专为一线应急响应设计，在仅有手掌大小且防尘防水的坚固机身中，提供了标准热点六倍的发射功率。正是由

于摒弃了笨重的传统散热方案并采用了 AirJet®，才使得这种极致的性能与便携性成为可能。

通过在紧凑、坚固的设计中实现高功率持续输出，AirJet® Mini 已在性能、可靠性和信任度不可逾越的任务关键型环境中证明了其价值。

AirJet®：专为“AI 推理与逻辑推理模型”的崛起而生

随着边缘端 AI 从简单的“推断（Inference）”向“逻辑推理（Reasoning）”模型进化，工作负载正变得更加持久且计算密集。这些模型需要更长的“思考”时间，对边缘设备产生了巨大的散热需求。

AirJet®Mini G2 专为此类转变而设计。在保持同样超紧凑体积的前提下，其散热能力较第一代 AirJet Mini 提升了 50%，使处理器能够保持高水平性能而不触发降频。这一进步契合了“Frore 定律”（Frore’s Law）——即公司提出的每两年将散热性能翻倍的长期愿景，旨在紧跟 AI 算力的进化步伐。

无风扇设计下的持续 AI 性能

在超紧凑边缘系统中，散热限制（而非计算能力）是首要制约因素，而笨重的散热片或噪音巨大的风扇并非可行方案。AirJet®Mini G2 凭借仅约 2.65 mm 厚度的芯片克服了这一热力挑战。

在 CES 上，Frore Systems 正在演示 AirJet®Mini G2 的多项应用，包括：

- Qualcomm 二合一笔记本参考设计：在超薄设备中实现静音且高性能的运作。
- Qualcomm 迷你电脑（Mini-PC）参考设计：在超紧凑的外壳中释放持续的桌面级性能。

这些设备利用 AirJet®Mini G2 随时间推移保持峰值性能，有效避免了因热量积聚导致在短时间脉冲运行后被迫降频的问题。

AirJet®Mini G2 技术亮点

- 散热功率：7.5 W（较 AirJet Mini G1 提升 50%）
- 尺寸：仅 27mm × 41.5mm × 2.65 mm，支持超紧凑设备
- 背压能力：1,750 Pa（约为风扇的 10 倍），支持防尘防水设计
- 噪音水平：21 dBA，实现近乎静默的运行
- 设计架构：全固态，无机械活动部件，使用寿命长

AirJet®Mini G2 的工作原理是产生高速脉动气流，高效地从紧凑外壳中排出热量，从而支持美观、轻盈、超紧凑、静音、无振动、防尘且防水的设备设计。其小尺寸和可扩展性意味着制造商可以在笔记本电脑、平板电脑、迷你电脑、智能手机、5G WiFi 热点、摄像机、SSD 以及海量物联网设备中，显著提升持续性能。

连续三年蝉联 CES 创新大奖

Frore Systems 连续第三次获得 CES 创新奖，这标志着行业日益意识到：散热技术已成为边缘端 AI 的核心性能赋能者。

“AI 逻辑推理模型需要的是持续的性能，而非短时间的爆发，”Frore Systems 创始人兼首席执行官 Seshu Madhavapeddy 表示，“AirJet®Mini G2 消除了长期制约超紧凑系统的散热屏障，让超薄二合一笔记本和迷你电脑等消费产品能够思考更久、运行更快，并保持静默。这一奖项验证了我们的信念：固态主动散热是下一代超紧凑边缘 AI 设备的基础。”

2026 年 CES 现场演示

Frore Systems 将演示搭载 AirJet 和 AirJet PAK 技术的边缘 AI 设备，以及 Qualcomm Snapdragon X2 Elite 计算参考平台。此外，还将现场演示 LiquidJet，展示其冷却 1,950W NVIDIA Rubin 的性能、600W/cm²的极端热点冷却能力，以及单掩膜 1,200W ASIC 散热方案。

- 时间：1 月 6 日至 9 日
- 地点：拉斯维加斯威尼斯人会展中心（Venetian Expo）2 层 2401B 室

关于 Frore Systems

Frore Systems 是先进热管理技术的先驱，致力于释放数据中心及边缘设备的性能潜力。公司的旗舰方案包括：

- *LiquidJet™ :* 面向数据中心的多级 3D 短循环喷射通道液冷冷板。该方案旨在通过芯片直连冷却突破散热瓶颈，助力释放更高 GPU 性能、优化电源使用效率（PUE）并显著降低总拥有成本（TCO）。
- AirJet®：全球首款用于消费、工业和物联网市场的固态主动散热芯片。该技术通过独特的固态架构，助力超紧凑型、静音、轻质、防尘防水的边缘设备实现更高性能，让设备在各种严苛环境下依然能保持巅峰算力。

Frore Systems 的专利散热技术已被全球主要原始设备制造商（OEM）和系统集成商整合。公司总部位于美国硅谷，在台湾设有制造基地。

媒体联系人：

Sue Ryan - VP Marketing, Frore Systems

邮箱：sue@froresystems.com

手机：+1 314 914 5008

Would you like me to create a shortened version of this press release for a social media post?